|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 中国科学院半导体研究所因公出访信息事后公示表 | | | |
| 出访项目名称 | 2025年欧洲固态电路会议 | | |
| 所属部门 | 半导体芯片物理与技术重点实验室D | 批件文号 | [2025]科际批字5722号 |
| 实际出访时间 | 2025-09-07至2025-09-13 | 实际出访天数 | 7 |
| 出访国家或地区 | 德国 | 团组人数 | 1 |
| 团长姓名及职务（职称） | 祁楠 研究员 | | |
| 团组成员姓名及职务（职称） | 祁楠 研究员 | | |
| 实际日程安排 | 9月7日北京乘飞机出发，当天抵达德国法兰克福入境，随后乘火车转赴慕尼黑；9月8-11日在慕尼黑参加欧洲固态电路会议；12日乘飞机由慕尼黑出境返回，13日到达北京。 | | |
| 费用来源 | 人员所在单位支付 | | |
| 经费开支明细（由外方负担全部出访费用可不填写） | | | |
| 经费使用情况 | 出国预算 | | 实际支出 |
| 国际旅费 | 15000人民币 | | 14561人民币 |
| 住宿费 | 1020欧元 | | 1020欧元 |
| 伙食费 | 420欧元 | | 420欧元 |
| 公杂费 | 266欧元 | | 266欧元 |
| 国际会议注册费 | 740欧元 | | 740欧元 |
| 交通费 | 100欧元 | | 29.5欧元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 200人民币 | | 200人民币 |
| 合计 |  | |  |
| 出 访 总 结 | | | |
| 本次出访参加了主会场和分会场报告、技术论坛；通过交流了解到国际范围科研机构、企业的研究热点、水平和趋势。特别是在高速光互连收发芯片等分会场，了解到光I/O芯片和光模块互连方向的技术创新，为2025年下半年本课题组的研究提供了参考和支持。会议期间，本组成果“A 3D-Integrated, 4λ×128Gb/s WDM Si-Photonic Receiver for Chiplet Optical I/O”进行了口头报告，与国际同行面对面进行了交流，获得广泛的认可。 | | | |
|  |  |  |  |